



Workshop Aufbau- und Verbindungstechnik der Forschungslabore Mikroelektronik Deutschland

Wann: 29. März 2022, 15:00 Uhr – ca. 17:00 Uhr

Wo: Online – ForLab Abschlusskonferenz

Das Forschungslabor Mikroelektronik Ilmenau für neuromorphe Elektronik ist Organisator des Workshops für Aufbau- und Verbindungstechnik. Ziel des Workshops ist die Kompetenzerfassung und die Vernetzung der ForLabs, die wesentliche Forschungsschwerpunkte in der mikroelektronischen Aufbau- und Verbindungstechnik haben und diese ausbauen. Darüber hinaus soll auch die Brücke zur Forschungsfabrik Mikroelektronik gespannt werden.

Vorläufiges Programm:

Zeit	Titel	Sprecher	Einrichtung	Forlab
15:00	Begrüßung	Jens Müller	TU Ilmenau	NSME
15:05	Impulsvortrag: Advanced Packaging: More than shipping to Southeast Asia	Michael Töpfer	FMD	-
15:25	THz-Komponenten- und Modultechnologie	Nils Weimann	Universität Duisburg-Essen	SmartBeam
15:40	Gedruckte Hochfrequenztechnik im D-Band	Georg Gramlich	KIT	DiFeMis
15:55	LTCC-basiertes Packaging für die Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik	Jens Müller	TU Ilmenau	NSME
16:10	AVT in der Leistungselektronik	Frank Schafmeister	Universität Paderborn	FutureLabPE
16:25	Beitrag von ForLab HELIOS zur AVT von photonischen und optofluidischen Systemen	Sven Bohne	TUHH	Helios
16:40	Dünnschicht- und Drucktechnologien für das Packaging in sensorischen und optischen Anwendungen – Effekte durch die ForLab-DCST Förderung	Krzysztof Nieweglowski/ Philip Knoch	TU Dresden	DCST
16:55 – 17:00	<i>Abschließende Diskussion</i>			